



CMP 技術の基礎を理解するサマーキャンプ 2026

(公社)精密工学会 プラナリゼーション CMP 委員会

目的

- CMP に携わる研究者, 技術者からマーケティング, 営業まで全てのビジネスパーソン向けのシリコン半導体デバイスを主とした CMP 集中セミナー.
- ビジネスリーダー育成のきっかけづくりとなる「学びの場」の提供.
- 次世代を担うビジネスパーソンが半導体の技術, 産業について考える契機に.

日時

8月7日(金) 8:45~ 8月8日(土) 17:00 1泊2日

場所

ホテルアジュール竹芝

〒105-0022 東京都港区海岸 1-11-2 TEL 03-3437-2011

<http://www.hotel-azur.com/>

対象者・募集人数

対象者： CMP に携わる研究者, 技術者からマーケティング, 営業にいたるビジネスパーソン及び CMP 技術全般の動向を理解されたい方

募集人数： 60 名

概要

本セミナーは, 半導体デバイス製造技術の基礎として, CMOS プロセスと製造前工程・後工程技術について幅広く説明します. その中で, 半導体製造前工程における CMP 技術に焦点を当て, CMP の原理, プロセス, 装置, 材料, 先端 CMP アプリケーション, 洗浄・クリー

ン化技術, そして産業動向の 7 つの観点で, 基礎から応用までを網羅した分かりやすい説明を行います. このセミナーは, CMP 技術を理解するための入門講座としておすすめです. 半導体製造プロセス全般を学ぶことを踏まえて, 基礎から応用までを包括的に学ぶことができます. CMP 技術の重要性や役割について理解を深め, 半導体デバイス製造における平坦化の重要性を把握することができるでしょう.

講義内容

講義 1 CMOS プロセス技術の基礎概説

講義 2 CMP の原理

講義 3 CMP プロセス

講義 4 CMP 装置

講義 5 CMP 材料

講義 6 CMP スラリーと洗浄

講義 7 先端ロジックの CMP

講義 8 先端メモリの CMP

講義 9 難加工材料の CMP

講義 10 先端パッケージと CMP

講義 11 半導体ビジネスと CMP 市場展望

・ **グループ討議** ワールドカフェ

参加者主体の会議でテーマ議論を行い, 相互の交流と議論の深化を図る.

・ **確認テスト**

講師

ワイドヴィル (元東京エレクトロン株式会社) 廣田 良浩

九州大学大学院 黒河 周平

株式会社レゾナック 近藤 誠一

株式会社荏原製作所 梶川 敬之

ニッタ・デュポン株式会社 小川 一幸

株式会社フジミインコーポレーテッド 森永 均

株式会社 ISTL 磯部 晶

株式会社日立ハイテク 松崎 望

長岡技術科学大学 會田 英雄

株式会社レゾナック 乃万 裕一

グローバルネット株式会社 武野 泰彦

〈ファシリテーター〉

キオクシア株式会社 渡邊 崇史

神戸大学 鈴木 教和

効果・到達目標

座学のみならず, グループ討議を通じた講師・受講者双方向の能動的な学習を行うことにより, 半導体デバイス製造技術および CMP 技術と産業動向全般の理解を深める.

スケジュール (一部変更の可能性がございます。)

8月7日(金) 1日目

8:45-9:00 オープニング

9:00-12:00 講義 1 CMOS プロセス技術の基礎概説 (ワイドヴィル 廣田良浩)

12:00-12:45 昼食休憩

12:45-13:45 講義 2 CMP の原理 (九州大学大学院 黒河周平)

13:50-15:35 講義 3 CMP プロセス (株式会社レゾナック 近藤誠一)

15:45-16:45 ワールドカフェ

16:55-17:55 講義 4 CMP 装置 (株式会社荏原製作所 梶川敬之)

18:00-19:00 講義 5 CMP 材料 (ニッタ・デュポン株式会社 小川一幸)

19:20-21:00 夕食・懇親会

8月8日(土) 2日目

7:00-8:00 朝食

8:00-9:30 講義 6 CMP スラリーと洗浄 (株式会社フジインコーポレーテッド 森永均)

9:40-10:40 講義 7 先端ロジックの CMP (株式会社 ISTL 磯部晶)

10:45-11:45 講義 8 先端メモリの CMP (株式会社日立ハイテク 松崎望)

11:45-12:00 記念撮影

12:00-12:40 昼食休憩

12:40-13:10 確認試験

13:15-14:15 講義 9 難加工材料の CMP (長岡技術科学大学 會田英雄)

14:20-15:40 講義 10 先端パッケージと CMP (株式会社レゾナック 乃万裕一)

15:45-16:45 講義 11 半導体ビジネスと CMP 市場展望 (グローバルネット株式会社 武野泰彦)

16:45-17:00 クロージング

確認試験

CMP 集中講義からの出題と語彙確認

語彙確認は、図解 半導体用語集 第7版(サクセスインターナショナル株式会社 制作・監修, グローバルネット株式会社発行)より出題いたします。

※希望者のみ購入可 3,300円(税込み)

受講料

85,000円(税込み)

シングル部屋1泊宿泊費, 食費4回分, テキスト代込

- ・お申し込み者数が定員に達している場合には、お申し込みいただけない場合があります。
- ・やむを得ずキャンセルの場合は、原則開催日の 3 営業日前の午後 3 時までにご連絡をお願いいたします。
- ・開催 14 日前以降のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
- ・代理参加は受付いたします。

お申込み

ホームページからのオンライン参加登録をご利用ください。

連絡先

「プランリゼーション CMP 委員会」事務局（中村）

TEL; 03-5962-3145 / FAX; 03-5962-3146

Email : nakamura@global-net.co.jp